



LOTPASTE SP2200

Bleifreie No-Clean-Lotpaste REL0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Stannol SP2200 Lotpaste ist für den Einsatz mit der Legierung TSC405 (Sn95,5Ag4Cu0,5) und TSC305 (Sn96,5Ag3Cu0,5) als Standardlegierung entwickelt worden. Sie enthält ein hochaktives Typ L No-Clean-Flussmittel. Mit einer speziellen Formel für ausgezeichnete Benetzung erfüllt sie die Anforderungen einer Großserienfertigung, bei der die Bauteile und Leiterplatten oftmals eine nicht optimale Lötbarkeit aufweisen. Die Benetzungseigenschaften wurden für alle bekannten bleifreien Leiterplatten- und Bauteilbeschichtungen optimiert. Die geringen Mengen an Rückständen nach dem Reflow sind elektrisch sicher und müssen nicht entfernt werden.

PRODUKTMERKMALE

Das Produkt bietet folgende Vorteile:

- **speziell zum Einsatz mit bleifreien Legierungen entwickelt**
- **geeignet für Fine-Pitch bis 0,4 mm**
- **sehr gutes Andrucken nach längerer Druckerstillstandzeit**
- **Reflow unter Luft oder Stickstoff möglich**
- **sehr gute Benetzung auf allen Oberflächen, auch Ni und Pd**
- **hohe Nassklebekraft für Einsatz auf High-Speed-Bestückautomaten**
- **sehr gut für großflächige Lötungen geeignet**

ANWENDUNG

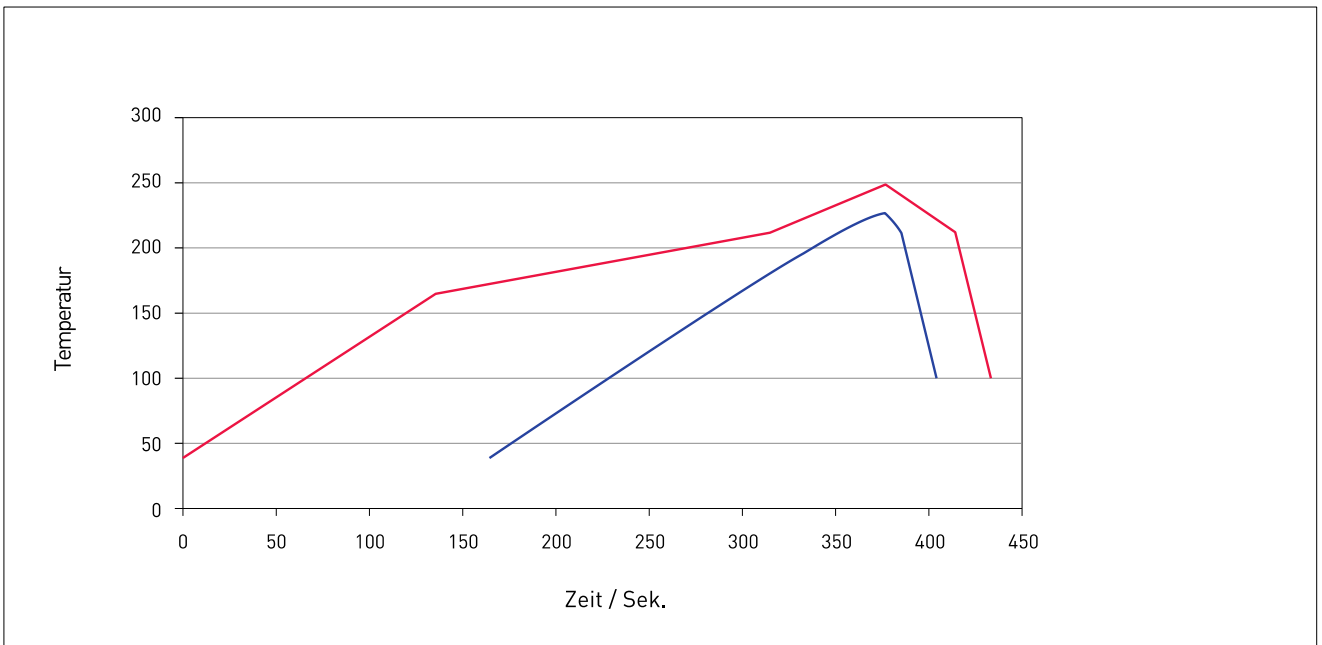
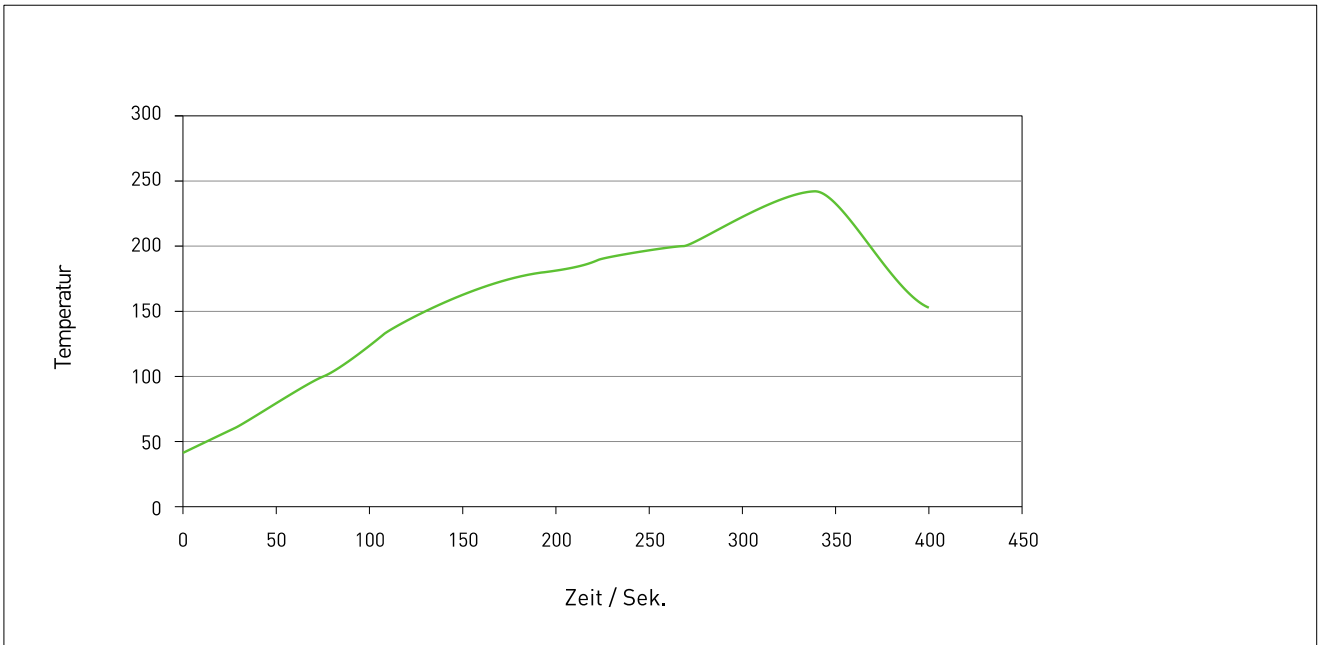
Pastendruck: Die Lotpaste SP2200 wurde für den Schablonendruck entwickelt. Mit der TSC405- bzw. TSC305-Legierung als Lotpulver in der Klasse 3 (25-45) und 4 (20-38 µm) ist die Lotpaste SP2200 in allen gängigen offenen und geschlossenen Drucksystemen einsetzbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSPARAMETER	
bei Korngröße 4	0,4-0,65 mm Pitch bei 150 µm Schablonenstärke
bei Korngröße 3	< 0,4 mm Pitch bei 120 µm Schablonenstärke
Minimale Padbreite:	200 µm bei 150 µm Schablonenstärke

Empfehlungen für den Pastendruck:

1. Verwenden Sie generell die geringstmögliche Schablonenstärke.
2. Verwenden Sie Schablonen mit gerundeten Ecken, um ein Zusetzen der Schablonenöffnungen mit Lotpaste zu minimieren.
3. Stellen Sie den Rakeldruck auf 1 kg pro 5 cm Rakellänge ein. Dann den Rakeldruck in kleinen Schritten soweit verringern, bis die Lotpaste anfängt zu schmieren. Anschließend den Gesamtdruck wieder um 1 kg erhöhen. Jetzt ist die Rakelkraft auf das Optimum zwischen Verschmiersicherheit und Rakelabrieb eingestellt. Nehmen Sie diese Einstellungen bei der von Ihnen gewünschten Druckgeschwindigkeit vor.
4. Optimale Druckgeschwindigkeit mit der SP2200 Lotpaste liegt in dem Bereich von 10-75 mm sec⁻¹.
5. Achten Sie genauestens auf die Abdichtung von Leiterplatte und Schablone. Die Leiterplatte muss sehr gut unterstützt sein, damit sie gegen die Schablone abdichtet und die Lotpaste nicht seitlich an den Pads vorbeigedrückt werden kann.
6. Stillstandzeiten des Druckers bis zu einer Stunde können realisiert werden. Der folgende erste Druck weist direkt ein gutes Ergebnis auf.

Reflowprofile: Der Reflowprozess kann unter Luft und unter Stickstoff erfolgen. Folgend ist ein typisches Temperaturprofil aufgeführt, das bei der Verwendung mit der Lotpaste SP2200 gute Benetzungsergebnisse gezeigt hat. Es können aber auch, je nach vorhandener Anlagentechnik und Lötgut, andere Profile verwendet werden. Für diese Lotpaste wird ein lineares Reflowprofil empfohlen, bei Verwendung eines Sattelprofils sollte die Temperaturbelastung in der Vorheizung bei Temperaturen um 180 °C eine Zeit von 120 sec nicht überschreiten.



EMPFEHLUNGEN PROZESSFENSTER	MAX (ROT)	MIN (BLAU)
Peaktemperatur:	250 °C	230 °C
T>217 °C:	100 sec.	30 sec.
100 °C bis 217 °C:	260 sec.	130 sec.

REINIGUNG

Stannol SP2200 wurde als No-Clean-Lotpaste entwickelt. Das bedeutet, dass eine Entfernung der Rückstände nicht erforderlich ist. Ist eine extrem hohe elektrische Sicherheit zu gewährleisten, können Oberflächenisolationswiderstandsmessungen und Messungen der ionischen Kontamination helfen, eine Entscheidung über die Notwendigkeit der Reinigung zu treffen. Sollte eine Reinigung erforderlich sein, können die Rückstände in herkömmlichen Reinigungsprozessen entfernt werden. Zur Reinigung wird der Stannol-Reiniger Flux-Ex Post empfohlen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Lotpulver: Die erlaubten Verunreinigungen in diesem Lotpulver entsprechen der ANSI/J-STD-006 und DIN EN 29453. Die nominelle Lotpulverpartikelgröße beträgt 25-45 µm (Typ3) bzw. 20-38 µm (Typ 4) mit einer exakt kontrollierten Korngrößenverteilung und Kugelform.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	SP2200 TSC405-89-3 / SP2200 TSC305-89-3 / SP2300 TSC305-89-4
Legierung:	Sn95,5Ag4Cu0,5 (Ecoloy TSC405) / Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5 (ECOLOY TSC305)
Schmelzbereich, °C:	217-223
Metallgehalt, %:	89
Lotpulver, µm:	25-45 (Typ 3) / 20-38 (Typ 4)
Applikation:	Schablonendruck
Viskosität Brookfield cPs(1), 25°C	550.000-850.000
Physika CSR at 10rpm, Pas	130 +/- 40
Dichte g/cm ³	3,9 +/- 0,2

(1) Gemessen bei 25 °C, TF Spindel bei 5 Upm nach 2 Minuten

Tests	Spezifikation	Ergebnis
Kupferkorrosion:	ANSI/J-STD-004B	bestanden
Kupferspiegelkorrosion:	ANSI/J-STD-004B	bestanden
Oberflächenisolationswiderstand:	ANSI/J-STD-004B – IPC-TM650	bestanden
	JIS-Z-3284 85 °C/85 % rF	bestanden
	JIS-Z-3284 40 °C/90 % rF	bestanden
	DIN IEC 61189	bestanden
	Bellcore GR-78-Core (1997)	bestanden
Silberchromatpapiertest:	ANSI/J-STD 004 / QQS-571	bestanden
Chloridanteil:	IPC-TM-650	<20ppm
Bromidanteil:	IPC-TM-650	< 20ppm
Lotkugeltest:	nach 1 h bei RT	bestanden, Klasse 1
	nach 24 h bei RT	bestanden, Klasse 1
Nassklebekraft:	JIS-Z-3284	mindestens 100 g nach 24 h
Offenzeit:	laborinterne Spezifikation	mindestens 8 h bei 23 °C/65 % r.F.
Klasse der Flussmittelaktivität:	DIN 29454-1	1.2.2.C
	J-STD-004	RE L0

LIEFERFORMEN

Stannol SP2200 Lotpaste kann in den folgenden Gebinden geliefert werden:

- 500 g Kunststoffdosen
- 600 g Semco oder 1200 g vakuumgefüllte Semco-Kartuschen

Auf Anfrage stehen auch andere Verpackungsarten zur Verfügung. Diese können mit bestimmten Mindestabnahmemengen verbunden sein.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bei einer Lagertemperatur von 2-8 °C beträgt die Mindesthaltbarkeit (ab Herstellungsdatum) 6 Monate (Dose) bzw. 3 Monate (Kartusche) im ungeöffneten Originalbehälter. Lotpaste in Kartuschen (Semco 6 & 12 oz) oder Spritzen (< 30 cc) sollten aufrecht stehend mit der Verschlusskappe der Dosieröffnung nach unten gelagert. Ist dies nicht möglich, empfehlen wir die liegend gelagerten Kartuschen einmal pro Woche um 180 ° zu drehen, um eine Separation zu vermeiden. Lassen Sie die Lotpaste vor Verarbeitung ca. 8-12 Stunden langsam im geschlossenen Originalbehälter auf Raumtemperatur erwärmen, um eine Kondensation von Luftfeuchtigkeit auf der Oberfläche zu verhindern.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt lesen und die Sicherheitsmaßnahmen beachten.

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.